

日月光九十二年度第三季業績簡訊

日月光於台灣時間 92 年 10 月 30 日同步於美國及台灣兩地發佈九十二年度第三季獲利報告，本公司第三季單季之合併營業收入較第二季成長 14%，較去年同期成長 22%，為新台幣 14,525 百萬元。茲將日月光第三季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

表(一)簡明營運成果分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	92 年度第三季	92 年度第二季	91 年度第三季
營業收入	14,525	12,773	11,861
營業毛利	2,783	1,970	1,885
營業利益(損失)	826	159	222
稅前純益(損失)	337	(139)	(270)
稅後純益(損失)	583	360	315
稅後 EPS(元)	0.16	0.10	0.09

表(二)整體業務之產品結構及客戶組成

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	32
汽車及消費性電子產品	29
個人電腦	39
其他	0
前十大客戶佔營收比重	53
IDM 客戶佔營收比重	48

表(三)銷售地區分析

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	57
歐洲	9
台灣	30
日本	2
亞洲其他地區	2

表(四)封裝業務

產 品 組 合	占營收比率(%)
BGA & Other Substrate-based	54
QFP, TQFP, LQFP	25
PDIP, PLCC, SOs	9
Others	12
封裝資本支出金額	38 百萬美元
第三季打線機台數	4,808

表(五)測試業務

產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	78
晶圓測試	18
前段測試	4
測試資本支出金額	36 百萬美元
第三季測試機台數	1,145

日月光公司董事長張虔生表示：“日月光集團合併營收在2003年第三季已經達到145億新台幣，是日月光成立以來的單季歷史性高點，這樣的高成長背後，主要是來自於我們的客戶需要先進封裝技術的支援，特別是在電腦和通訊領域。

由於我們在技術的研發以及在先進的封裝和測試產能的持續的投資，使我們佔有一個相當有利的位置，並成為產業中真正的領導者。過去幾季以來，由於我們正確的在產能上的積極性擴張，使得我們在客戶需求的推升下，產能利用率有效的提昇、獲利率也跟著不斷的增進，而在業界先進技術產能有限的情況下，價格也保持相當的穩定性。

除了我們的封裝和測試產能不斷的在提昇，在基板的營運上，我們也有了重要的進展。跟一年前同一時期相比，我們的基板營收成長率已經超過100%，基板部門對集團也開始有了利潤的貢獻。從目前的需求來看，以傳統導線架的封裝產品正快速的轉換到以基板為主的封裝，基板的需求目前遠遠超過我們所能供給的範圍。展望未來，行業中任何一家封裝廠要能持續的獲利成長，關鍵就在於能獲得穩定的基板供應，並能從中獲取利潤。基於此，日月光公司在10月28日宣布與華通公司成立合資公司，日月光公司藉此可以獲得華通公司基板產能的支援，而華通公司也得以在日月光現有客戶的基礎上開拓市場，將對雙方帶來極大的綜效。

同時，基於合併綜效的考量，我們也宣布日月光公司正式合併日月欣(日月光中壢)半導體與日月宏科技兩家公司，透過此合併案，我們將得以有效整合集團內資源以達到規模經濟的效益，並達到組織扁平化的好處，也將為我們的投資者與客戶提供更透明的營運資訊。”